

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform B/3,
Art. Nr. 102-78116-xx

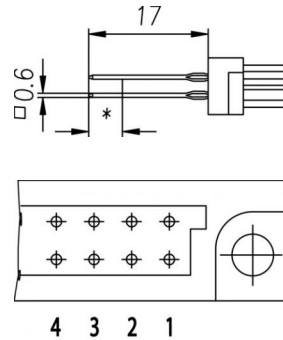
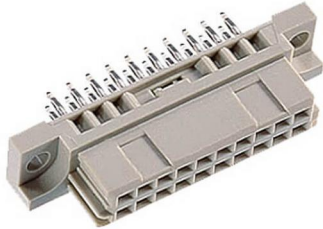


Abbildung ähnlich



Rechtwinklig



Einpresstechnik



Rugged

- Anschlusslänge 17 mm
- mit Steckzone in Gütestufe 2
- Polzahl 20
- Für LP 1.5 bis 2.0 mm: xx = 01_Für LP 2.0 bis 2.8 mm: xx = 02 (auf Anfrage)_Für LP > 2.8 mm: xx = 03
- Einpresstechnik
- Gütestufe 2



» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe [DIN 41612](#)

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform B/3,
Art. Nr. 102-78116-xx



Technische Daten

Grundlagen

Spezifikation	IEC 60603-2 (DIN 41612)
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	20
Anschlusstechnik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	17 mm
Leiterplattenabstand	16.85 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

Mechanisch

Rastermaß	2.54 mm
Steckkraft	< 18 N
Ziehkraft pro Kontakt	> 0.15 N
Lebensdauer	400 Steckzyklen

Elektrisch

Betriebsstrom	1.5 A
Durchgangswiderstand	<20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	1.2 mm
Isolationswiderstand	> 10 ⁶ MΩ
Prüfspannung	1000 V

Zulassungen / Konformität

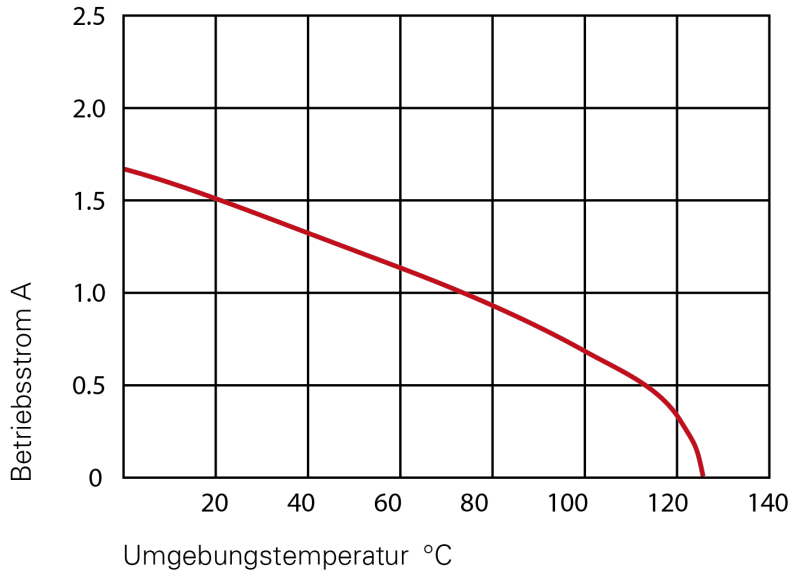
UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform B/3,
Art. Nr. 102-78116-xx



Derating Diagramm

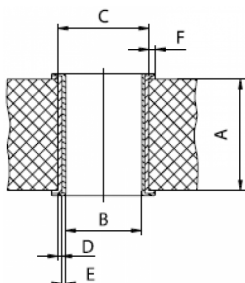


Bauform B, Q, C, R

20°C	1.5 A
70°C	1.1 A
100°C	0.7 A

Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
F Restring	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	OSP*, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	HAL Sn, 5 - 15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform B/3,
Art. Nr. 102-78116-xx



Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- ohne Befestigungsflansch
- Sonderlänge für Anschlüsse
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderbestückung

Zubehör

- » DIN 41612 Kodierung Bauform B und C
Artikelnummer 104-19003

Zeichnungen

Die Kundenzeichnung zu diesem Produkt erhalten Sie auf Anfrage unter sales@ept.de